

## 会社概要 (2023年12月31日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 928名 単体 445名
お問い合わせ先	045-478-7127(企画管理部)

## 株式情報 (2023年12月31日現在)

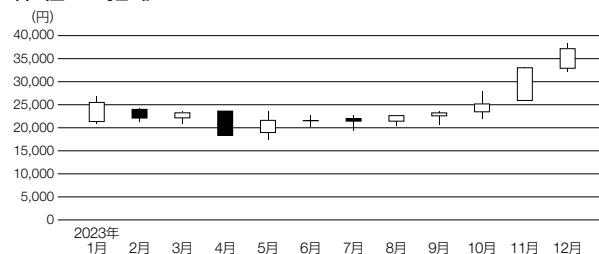
### 株式概要

上場市場	東京証券取引所プライム市場
発行済株式総数	94,286,400株
株主数	36,023名
大株主一覧	

	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	18,607	20.63
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	7,294	8.08
内山 洋	3,483	3.86
内山 秀	3,105	3.44
株式会社三菱UFJ銀行	3,008	3.33
前田 せつ子	2,734	3.03
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	2,263	2.50
STATE STREET BANKWEST CLIENT - TREATY 505234	1,524	1.69
UCHIYAMA HOLDINGS 株式会社	1,495	1.65
高橋 はる香	1,440	1.59

- (注) 1. 当社は、自己株式を4,098千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

### 株価の推移



### 取締役および監査役

取締役 会長執行役員 楠瀬 治彦	代表取締役 社長執行役員 岡林 理	取締役 副社長執行役員 仙洞田 哲也	取締役 専務執行役員 森泉 幸一
取締役 執行役員 三澤 祐太郎 田島 敦	取締役(社外) 三原 康司 上出 邦郎 岩田 宣子	常勤監査役 浅見 公一	監査役(社外) 石黒 美幸 出雲 栄一

### 株主メモ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)
単元株式数	100株
株主名簿管理人	三井住友信託銀行株式会社
特別口座管理機関	(同上)
同連絡先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(通話料無料) 郵送先 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。



(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三井住友信託銀行)にお問い合わせください。なお、三井住友信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行の本支店でお支払いいたします。

### 当社Webサイトのご案内

<https://www.lasertec.co.jp/ir/>

日興アイ・アール株式会社の「2023年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」にて総合部門最優秀サイトに選ばれました。



## 株主通信

# Lasertec News 30

第62期  
第2四半期累計期間  
2023年7月1日▶  
2023年12月31日

CREATE  
UNIQUE  
SOLUTIONS.  
CREATE  
NEW  
VALUE.

Lasertec

証券コード6920

## さらなる飛躍に向けて

代表取締役  
社長執行役員 **岡林 理**

この度の「令和6年能登半島地震」でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

### 第2四半期連結累計期間の業績報告

株主の皆さまには、日頃よりご支援とご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、エネルギーや原材料価格の高騰は緩和傾向にあったものの、インフレ圧力は依然として高く、欧米諸国の政策金利の高止まりなどにより、景気減速が懸念されました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、サプライチェーン全体の在庫調整局面が続くなか、ス

マートフォンやパソコンなどの最終需要に底打ちの兆しが見られました。しかしながら、半導体デバイスメーカーの多くは慎重な投資姿勢を継続し、最先端のEUV（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造能力の増強や次世代製造工程の開発に関わる投資も一定の水準にとどまりました。一方で、半導体市場は生成AIや車載向けを含めさまざまな用途で中長期的に拡大することが予想されており、世界各地で地政学リスクへの対

応を目的とした政府主導による半導体工場の新設・増設計画が進められております。また、半導体デバイスは、微細化による高性能化や消費電力の低減が継続的に求められており、半導体製造装置市場も中長期的に成長を続けると見込まれています。

このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は949億89百万円（前年同期比72.4%増）、営業利益は317億52百万円（同75.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が221億98百万円（同63.4%増）となり、売上、利益ともに上半期の過去最高を更新することができました。

通期の見通しにつきましては、為替変動の影響を鑑み、売上高1,950億円（前連結会計年度比27.6%増）、営業利益670億円（同7.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益490億円（同6.1%増）に上方修正いたしました。

### 第2四半期連結累計期間の受注状況

当第2四半期連結累計期間の受注高は725億35百万円となりました。半導体デバイスメーカーの多くは設備投資には慎重な姿勢を継続しているものの、生成AI関連やパワー半導体関連など特定分野への投資は堅調に推移しています。また、最終需要には底打ちの兆しもあり、サプライチェーン全体の在庫調整も進んできていることから2024年中の需要回復を見込んでいます。

### 中期経営計画フェーズ3+(プラス)\*

当期は中計フェーズ3<sup>+</sup>の最終年度です。2023年はChatGPTをはじめとした生成AIなど、半導体の新たな

アプリケーションに大きな注目が集まった年でした。一方で、スマートフォンやパソコンを中心とした最終需要が弱含んだことにより、半導体サプライチェーン全体では設備投資の調整局面が続きました。しかしながら、半導体市場は2024年中の回復が見込まれており、さらには中長期的に拡大を続けると予想され、当社にとっても大きな成長機会になるという見方に変わりはありません。半導体のさらなる進化を支える「微細化」「新構造」「新材料」といった絶え間ない技術革新を当社の成長の好機と捉え、EUV関連などの先端分野へ注力してまいります。下期には引き続き「成長を支える基盤強化」に努めるとともに、お客さまのご要望と市場の変化に即応して最先端ソリューションをタイムリーに提供し、より多く社会に貢献することにより事業の成長を目指してまいります。

\* 2021年7月から2024年6月までの3カ年中期経営計画

### 中間配当

中間配当額は1株当たり73円といたします。期末配当額は当初110円を見込んでおりましたが、この度の通期業績見通しの変更に伴い118円とし、年間では191円（前期比11円の増配）を予定しております。

レーザーテックは、「世の中にはないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」を経営理念として、当社の強みである光技術を生かしたビジネスを通じて世の中に貢献し、業績の向上につなげてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

# 業績ハイライト

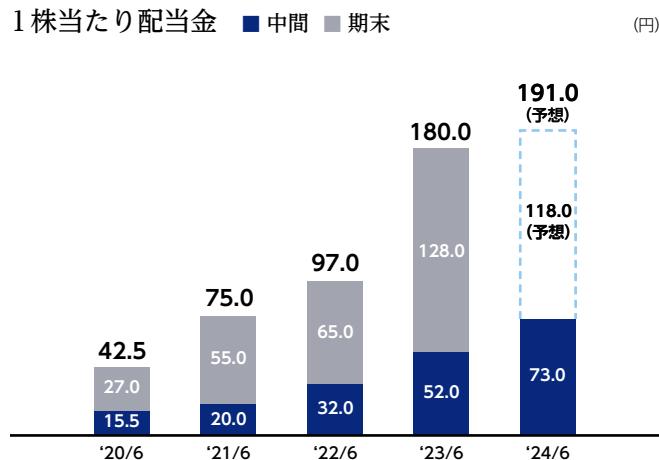
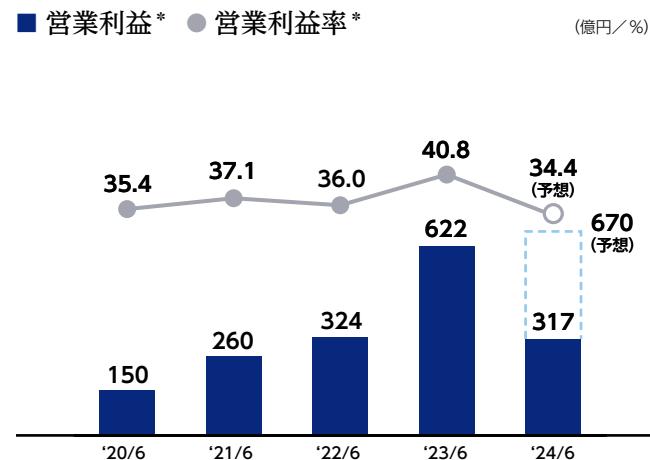
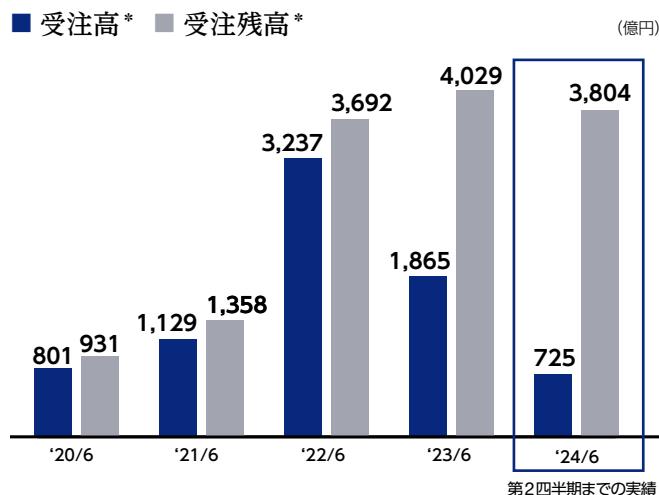
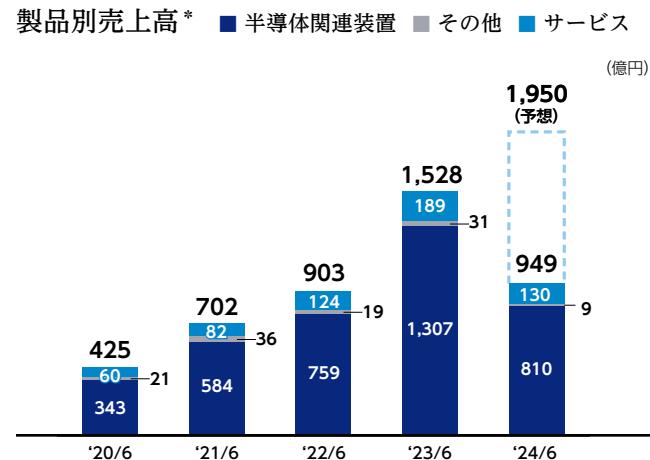
前年同期比 72.4% ↗ 売上高 **949億89百万円**

前年同期比  $\Delta$ 23.1% ↘ 受注高 **725億35百万円**

前年同期比 75.2% ↗ 営業利益 **317億52百万円**

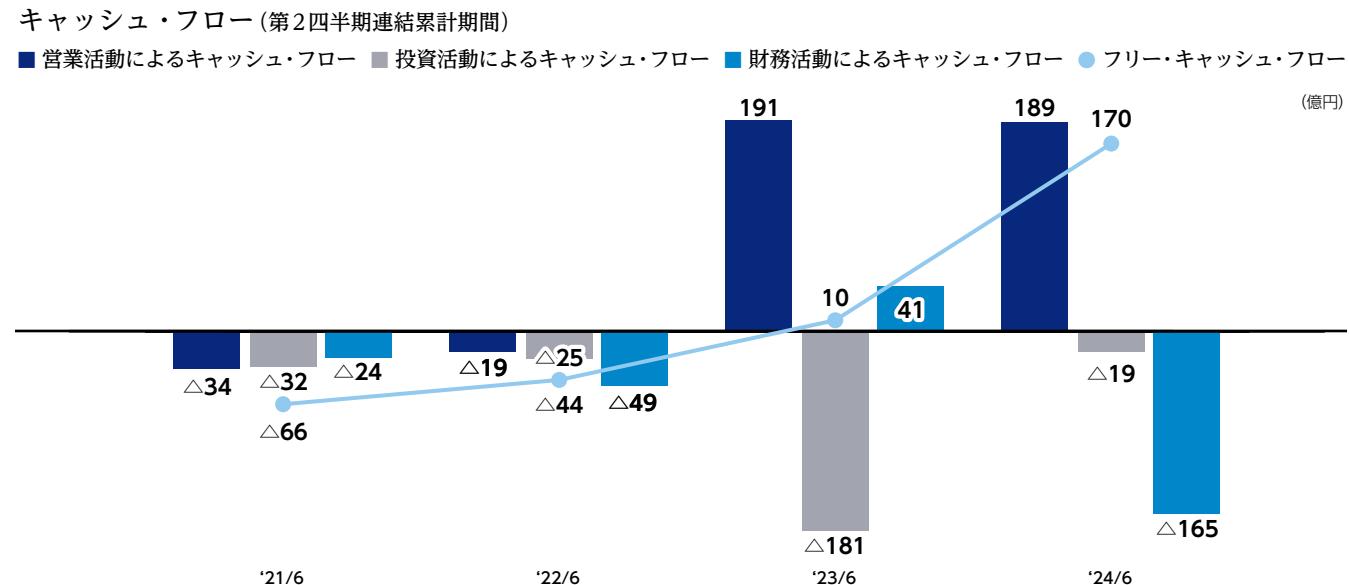
前年同期比 63.4% ↗ 親会社株主に帰属する四半期純利益 **221億98百万円**

自己資本 **1,196億74百万円** 資産合計 **2,523億41百万円**



\* '23/6期までは通期の業績、'24/6期は第2四半期連結累計期間の業績です。

(注) 2020年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。経年比較のため、上記の金額は2020年6月期の期首にこの株式分割が行われた仮定で算出してあります。



## 決算のポイント

### 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は1,196億95百万円となり、自己資本比率は47.4%となりました。

### 売上高/利益

半導体関連装置やサービスの売上向上により、売上高、利益ともに上半期の過去最高を更新しました。

### 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益や売上債権の減少などの収入要因が、法人税等の支払いや棚卸資産の増加などの支出要因を上回りました。

2023  
9/4

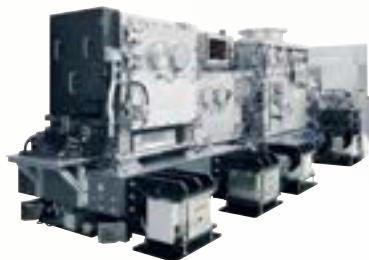
日経平均株価(日経225)  
構成銘柄に採用

日本経済新聞社が日経平均株価を構成する225銘柄の定期見直し(春、秋の年2回)を実施し、当社は初めて構成銘柄に採用されました。2023年10月2日の算出から反映されています。

2023  
9/12

高輝度EUVプラズマ光源  
「URASHIMA」を発表

マスク欠陥検査装置に最適な高輝度EUVプラズマ光源「URASHIMA」を発表しました。アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置「ACTIS」シリーズへの適用を進め、さらなる性能向上に努めていきます。



URASHIMA光源の特長

高輝度

高い安定性

エコ  
(低消費電力、低スズ消費)

検査に最適な  
プラズマサイズ

デブリフリー

2023  
10/1-5

国際学会  
「SPIE Photomask Technology  
+ EUV Lithography 2023」  
で2つの賞を受賞

フォトマスク技術およびEUV(極端紫外線)リソグラフィ\*に関する国際学会(米国、モンレー)において、2つの賞を受賞しました。

\*リソグラフィ: マスク原版に描かれた半導体デバイスの回路パターンを露光装置を使いウェハ上に転写する技術

1. BACUS Prize

フォトマスク業界への卓越した貢献を表彰する賞で、マスク検査装置「MATRICS X9ULTRA」シリーズによるEUVマスク検査への貢献が評価され受賞しました。当社としては2018年にEUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置「ABICS」での受賞以来2回目となります。



2. Best Paper Presentation Award

本賞は優れたプレゼンテーション上位3つを選出するもので、当社のプレゼンテーション「Actinic patterned mask inspection for high-NA EUV lithography(高NA\*対応アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置)」が1位を受賞しました。

\*NA: Numerical Aperture  
(開口数)



2023  
11/24

新製品  
アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置  
「ACTIS A300」シリーズを発表

さらなる微細化プロセスと高NA EUVリソグラフィに対応するACTISの次世代機として、アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置「ACTIS A300」シリーズを製品化しました。A300シリーズは新たに設計された光学系や自社開発した高輝度EUVプラズマ光源「URASHIMA」を採用し、従来のA150シリーズと比較しても非常に高い欠陥検出性能を実現しています。A300シリーズは現行のNAリソグラフィ向けと高NAリソグラフィ向け、両方のEUVマスク検査に対応している装置です。



2023  
12/17

TSMC社から「2023 TSMC Excellent Performance Award」を受賞

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (以下、TSMC社)より、「2023 TSMC Excellent Performance Award」を初受賞しました。

Excellent Performance Awardは、技術コラボレーション、グローバル生産サポート、品質コントロールなど各分野において卓越したパフォーマンスを発揮し、TSMC社の事業に年間を通して大きく貢献したサプライヤーに贈られる賞です。2023年に同賞を受賞した20社のうち、当社はマスク検査の分野で「Distinguished」の評価を受けた唯一のサプライヤーで、「Distinguished EUV Mask Inspection and Metrology Collaboration」として表彰されました。

